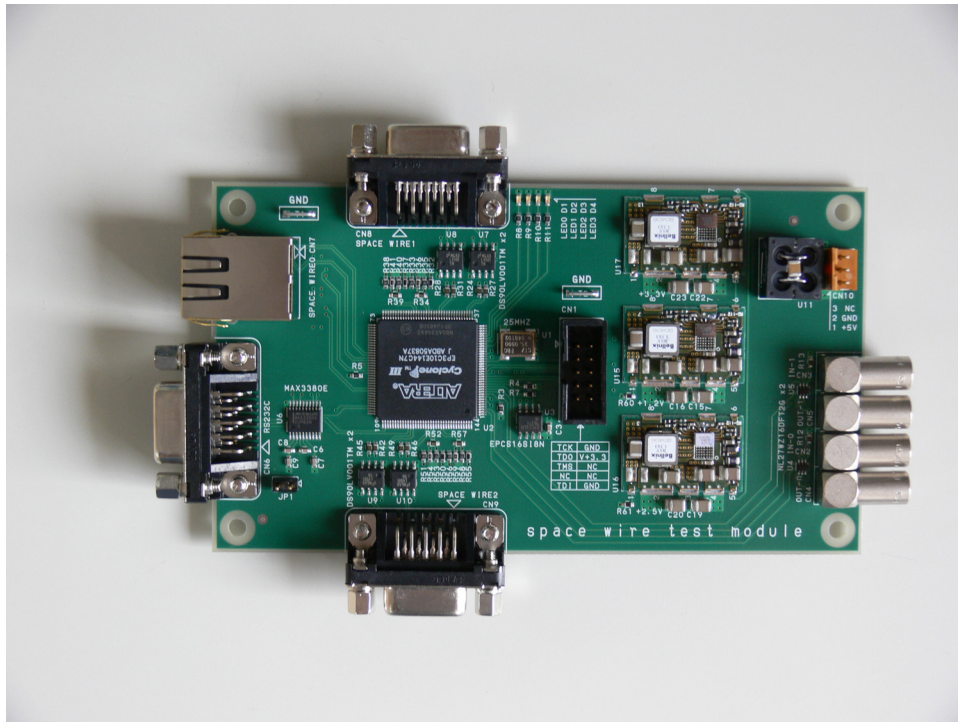


概説

現在使われている SPACE WIRE 規格モジュールのテスト用に 開発された プリント基板です。
さまざまな テスト機能を持ち合わせ 他種類の規格に対してインターフェイス機能があります。
各種試験用プログラムを利用するために FPGA集積回路が組み込みこんであり、機能変更にも
簡単に対応できる構造になっております。使用基板は4層です。



表面部品図面

仕様

配線基板素材：FR4
層数：4層プリント配線基板
板厚：1.6mm
サイズ：130x73.5 mm

機能：SPACE WIRE

コネクタ変換、プロトコルテスター、エラー試験装置

上記機能を RS213C、SPACE WIRE 等インターフェイスを使って行えます。

装着 I/F 用 コネクタ

SPACE WIRE DSUB 9PIN コネクタ2 個

LEMO 入出力コネクタ4 個

RS232C 用 DSUB 9PIN コネクタ1 個

SPACE WIRE RJ45 コネクタ1 個

電源：+5V 単一電源 2.5MM ピッチコネクタ